



Hope  
Successful  
Technology

HST

회사소개서

Copyright © 2014 by HST CO.,LTD.  
All rights reserved.

# CONTENTS

## I. 회사소개

1. 인사말
2. 회사개요
3. 경영방침
4. 회사연혁
5. 조직도

## II. 사업분야

1. 가공 사업부
  - 1) 압출 가공
2. 유통 사업부
  - 1) 플라스틱원자재
  - 2) Epoxy Adhesives

## III. HST vision

1. HST Vision & Future
2. 오시는 길





# 대표이사 인사말



안녕하십니까?

세상의 기술에서 새로운 가치를 발견하는 기업 (주)에이치에스티 입니다.  
날로 급변하는 세계 정세 속에서 각 기업들은 최상의 품질과 원가절감을 위해서 전 세계의 시장을 누비며 치열한 경쟁 속에서 고군분투하고 있습니다. 이러한 현실 속에서 각 기업들은 사실상 생존을 위한 치열한 싸움을 벌이고 있습니다.

이에 저희 (주)에이치에스티는 세계 정세에 발 맞추어  
기업이 필요로 하는 유익한 정보와 최상의 품질로 충족할 수 있도록 최선의 대응을  
위하여 전 임직원이 노력하고 있습니다.

회사의 사훈처럼 늘 기본에 충실하며 최선을 다 하여 새로운 가능성을 창출하여 발전하는 모습을  
보여 드리겠습니다.

다시 한번 찾아주신 여러분께 진심으로 머리 숙여 감사 드리며,  
지속적인 격려와 성원 부탁드립니다.

대표이사 신호성

(주)에이치에스티는 플라스틱 압출 전문 가공 및 소재 유통 전문 업체로서 신규 소재와 관련된 “Total Solution”을 제공 합니다.

특히 우수한 품질과 고 신뢰성 제품을 경쟁력 있는 Cost로 항상 고객 만족을 위한 Solution을 제공하기 위하여 노력하고 있습니다.

### Information

**회 사 명** ■ (주)에이치에스티

**대 표 자** ■ 신 호 성

**설립연도** ■ 2014년 2월 25일

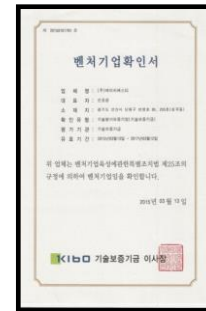
**자 본 금** ■ 1억 5천만원

**사업분야** ■ 플라스틱 가공업 (LCP 外) , EPOXY 접착제

**연 락 처** ■ TEL : 032-822-9677  
■ FAX : 032-822-9678

**주 소** ■ 한국 본사 : 인천 남동구 호구포로183 후이즈스마트타워 206  
■ 한국 공장 : 인천시 남동구 고잔로 54 (고잔동 382-14)  
■ 베트남 공장 : Plot CN8, Diem Thuy Industrial Zone, Diem Thuy commune, Phu Binh District, Thai Nguyen

### 인증 현황



### 사훈

---

인내 굳은 의지로의 정진  
비전 미래에 대한 영감  
정직 참된 기업정신

사훈

경영

### 경영방침

---

현장 중심 경영  
고객 만족 경영  
가치 창조 경영

### 품질방침

---

고객불량 Zero 달성  
고객중심 감성품질  
품질중심 Process 구현

품질

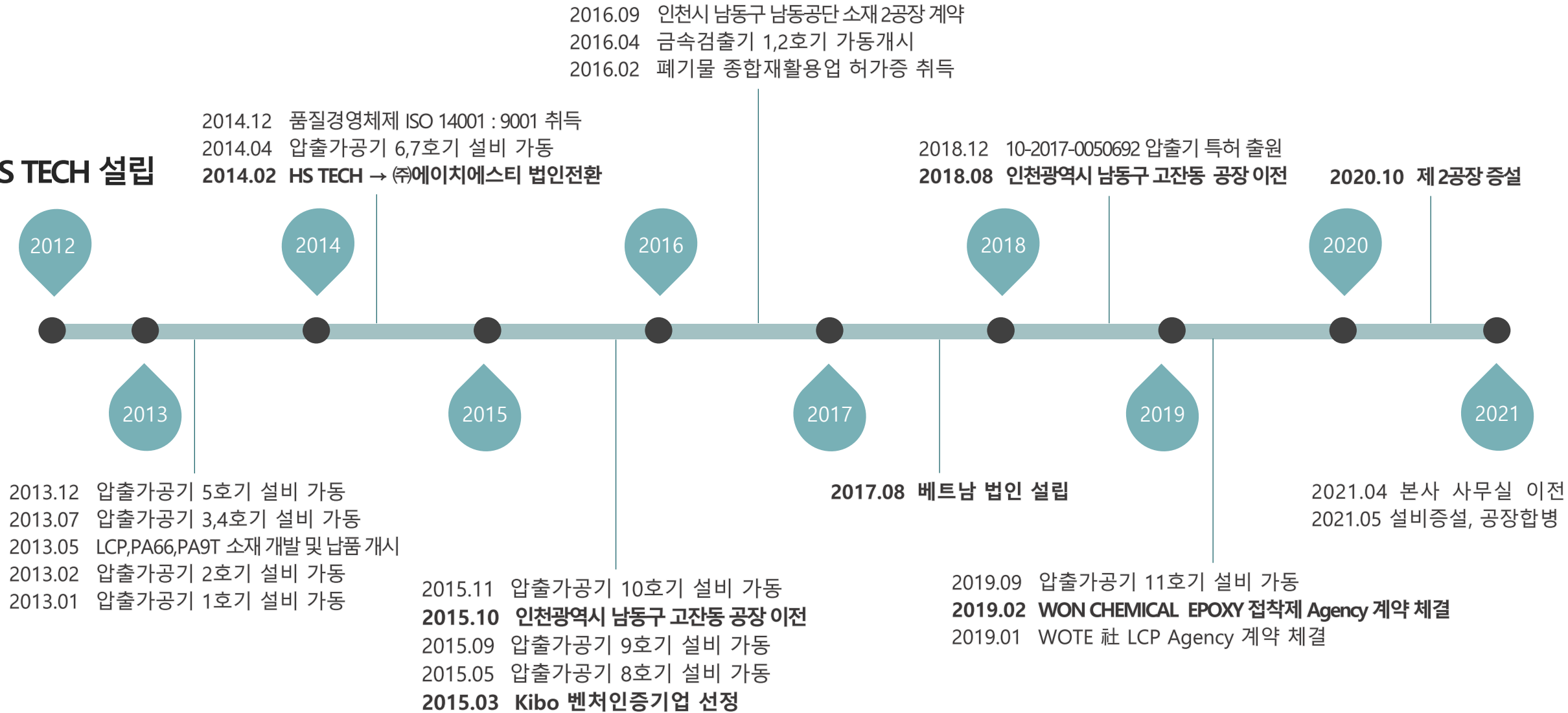
환경

### 환경방침

---

환경경영 시스템 운영  
오염물질 배출 최소화  
공개적 환경경영  
지속적 환경개선  
환경법규 준수

### HS TECH 설립

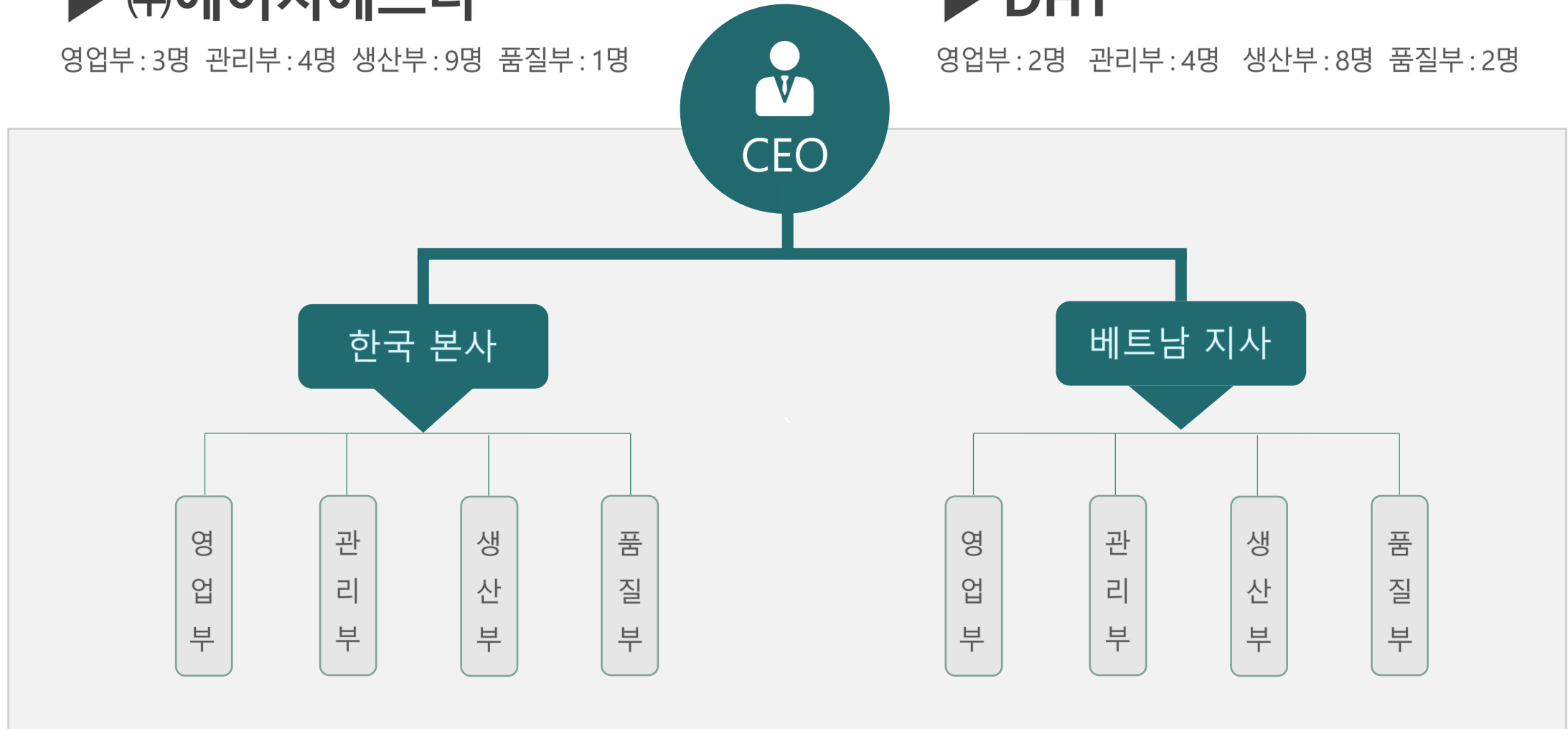


### ▶ (주)에이치에스티

영업부: 3명 관리부: 4명 생산부: 9명 품질부: 1명

### ▶ DHT

영업부: 2명 관리부: 4명 생산부: 8명 품질부: 2명





#### ■ 재생 플라스틱 사용 시 장점

- ✓ 사출 시 흐름성, 유동성, 충진이 좋아져 제품 생산성이 향상 됩니다.
- ✓ 재료비에 대한 부담을 줄일 수 있습니다.(원가절감)
- ✓ 고유의 GRADE를 그대로 재생산하여 본래의 물성을 유지시켜 신재와 혼합하여 사용하는 것도 가능 하도록 관리 생산 합니다.
- ✓ 사출 시 발생하는 폐 플라스틱(스프루,런너)을 재 활용 함으로써, 현재 사회적으로도 큰 문제가 되고있는, 환경적인 문제, 플라스틱 쓰레기 문제를 감소 시키는 친환경적인 사업입니다.



플라스틱 스크랩



분쇄기

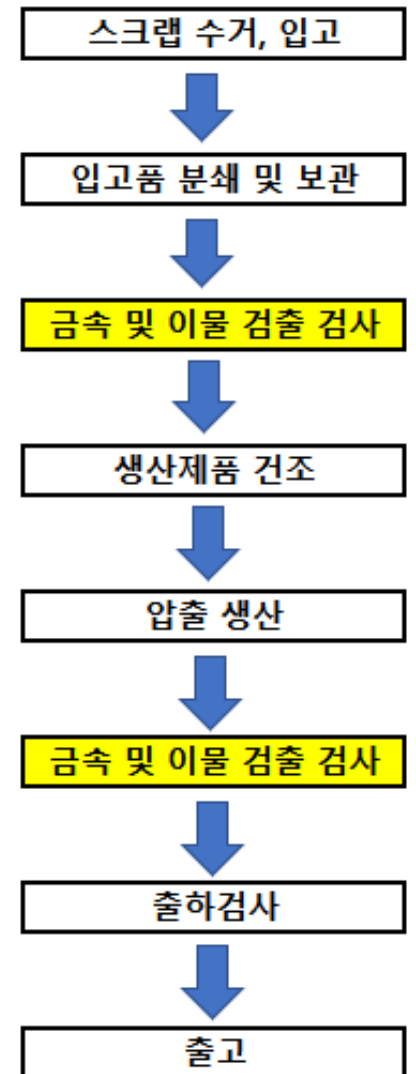


분쇄 후



압출 생산 후  
(신재와 동일한 상태)

#### 생산 공정



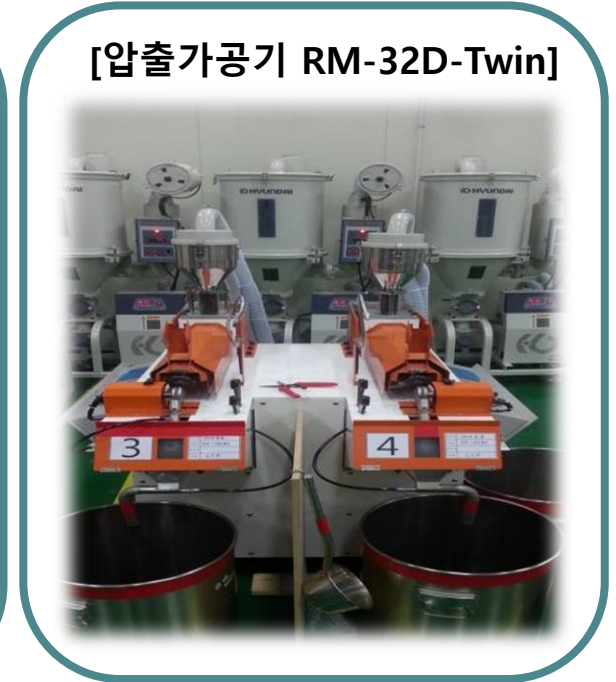
#### ■ 압출 가공이란?

고 가격의 플라스틱 분쇄재를 펠렛화 하여 신재와 같은 형태, 물성으로 가공하는 장치

#### ■ 장점

- √ 종래 방식으로 처리하기 힘든 고기능성 수지의 압출 가공이 가능  
(LCP, PPS, PA46, PA66, PBT 外 다수)
- √ 이동 설치가 간편하며 수지의 물성변화가 없음
- √ 설비 소형화 추세에 맞추어 소형 설비의 특성상 현장 및 품질 관리 용이

#### ■ 압출 가공기 보유 현황



| 구 분    | 설비명         | 형식             | 보유대수 | 비고                 |
|--------|-------------|----------------|------|--------------------|
| 압출 가공기 | RM-32D-Twin | 5~10kg / 1hr   | 6 대  | 소형기                |
|        | RM-32D      | 5~10kg / 1hr   | 1 대  | 소형기                |
|        | NHUK-40D    | 10~20kg / 1hr  | 3 대  | 일본 소형기             |
|        | JHT-35      | 10~20kg / 1hr  | 1 대  | 소형기                |
|        | HST-65D     | 40~50kg / 1hr  | 2 대  | 중형기                |
|        | STS-40      | 50~200kg / 1hr | 1 대  | 대형기(소재에따라 CAPA 상이) |
| 설비 옵션  | 건조기         | 0 ~ 200℃       | 13 대 | -                  |

#### ■ 일반 분쇄재 VS 압출 가공 재료 사용 비교

| 항 목   | 일반 분쇄재 사용시                 | 압출 가공 재료 사용시        |
|-------|----------------------------|---------------------|
| 원료 상태 | 입자가 불규칙 하며, 분진이 많음         | 신재와 동일하며, 분진이 전혀 없음 |
| 제품 품질 | 흑점, 변색, Gas 발생             | 100% 신재 사용과 차이가 없음  |
| 사출 조건 | 계량, 보압 및 사출조건의 변화 많음       | 100% 신재 사용과 차이가 없음  |
| 현장 환경 | 분진 발생으로 현장오염, 작업자의 건강문제 야기 | 100% 신재 사용과 차이가 없음  |



일반 분쇄재



압출 가공 후(펠릿)



압출 가공기 설비 현황 (소형기)





제품명 : LCP(E473i) VF



제품명 : PA46 MC50 BK



제품명 : PBT 3320 GF(BROWN)



제품명 : LCP(S475) BK



제품명 : PPS GP2400E NP



제품명 : PBT 1006 WHT

\* 상기 재료 외 산업용으로 쓰이는 거의 대부분의 수지(플라스틱 재료) 재생 가공이 가능합니다.

#### ■ 설비 및 계측기 현황

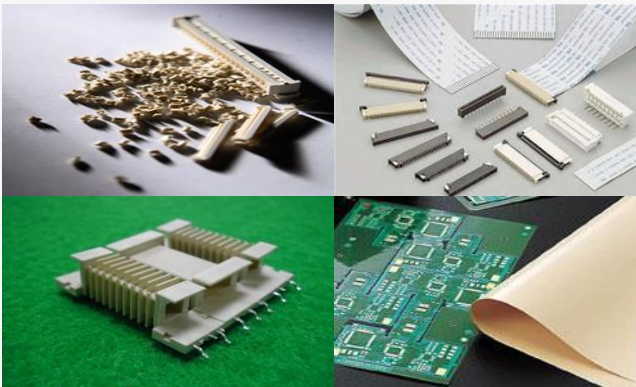
| NO | Maker    | 품 명                        | 수 량 |
|----|----------|----------------------------|-----|
| 1  | DMK      | 자가 재생 장치 싱글-32             | 1   |
| 2  | DMK      | 자가 재생 장치 RM-32D            | 6   |
| 3  | JHT      | 자가 재생 장치 2TR-35            | 1   |
| 4  | NHUK     | 자가 재생 장치 2TR-40            | 2   |
| 5  | NHUK     | 자가 재생 장치 2TR-40            | 1   |
| 6  | 세솔통상     | 자가 재생 장치 HST-65            | 2   |
| 7  | 한국이엠     | 자가 재생 장치 STS-40            | 1   |
| 8  | SEIKO    | 유해 물질 측정기 XRF-400          | 1   |
| 9  | 현대 전기 기계 | 이동식 호퍼 건조기 세트 (75K) HD-075 | 13  |
| 10 | 대호 특수 미싱 | 포장용 미싱기                    | 2   |
| 11 | 크러텍      | 신형 고속 분쇄기 (10 마력)          | 1   |

| NO | Maker     | 품 명               | 수 량 |
|----|-----------|-------------------|-----|
| 12 | 크러텍       | 신형 고속 분쇄기 (20 마력) | 2   |
| 13 | 크러텍       | 신형 고속 분쇄기 (3 마력)  | 2   |
| 14 | 크러텍       | 배합기               | 3   |
| 15 | 대한 전기 공업  | 컬러 혼합기            | 1   |
| 16 | 대한 전기 공업  | 금속 검출기 PNL-241W   | 1   |
| 17 | NHUK      | 분진 제거기            | 5   |
| 18 | 경원 컴프레샤   | 컴프레샤 세트 (10 마력)   | 2   |
| 19 | DOOSAN    | 지게차               | 2   |
| 20 | CAS       | 전자 저울             | 4   |
| 21 | 한일 전기 시스템 | 트랜스               | 4   |
| 22 | 현대전기      | 원료 이송 설비(500kg)   | 3   |



### SELCION® LCP (Liquid Crystal Polymer)

- 차세대 전자소재로 부각되고 있는  
고내열성 슈퍼엔지니어링플라스틱 소재
- 경박단소화 및 Pb-free 경향으로  
IT 제품용 전자소재로 적합
- 低선팅창률, 高탄성률, 치수 안정성,  
성형가공 특성 매우 우수



### Polyarylamide Ixef® 1022/9538

- Ixef® 1022는 매우 높은 강도와  
강성, 탁월한 표면 광택 및 우수한 내  
크리프 성을 나타내는 50 % 유리 섬유  
강화 일반 범용 폴리아릴 아미드 화합물

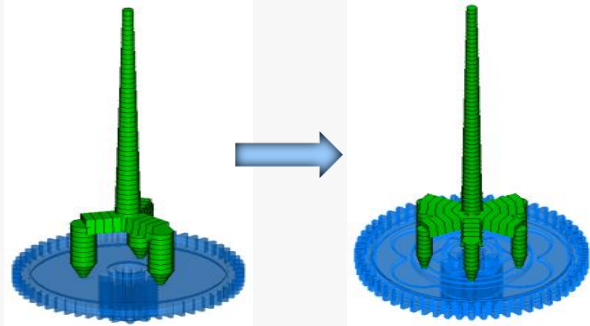


### PA66 / KN3322 V0HF KN332 G30 V0

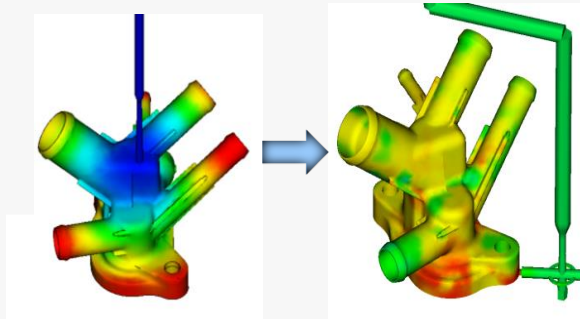
- 세계 최고 수준의 품질을 갖춘 POM,  
PA, PBT에서 Super EP인 PPS에 이르기까지  
국내에서 가장 다양한 제품 포트폴리오  
구축



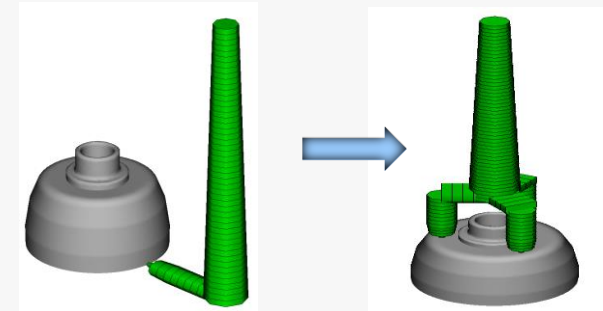




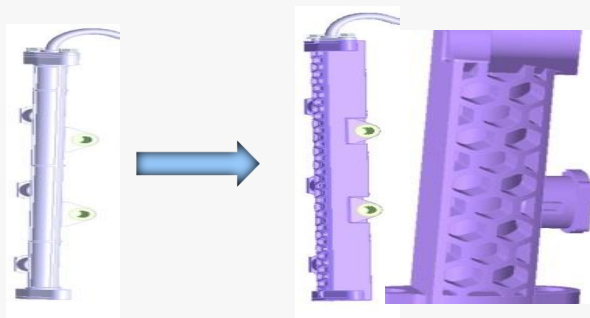
■ Gate 최적화 및 형상개선



■ Gate 최적화



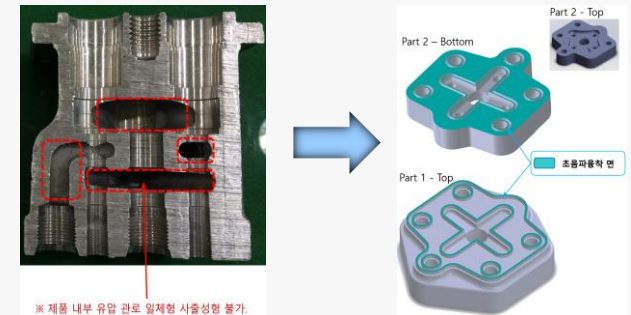
■ 품질문제 개선



■ 설계개선

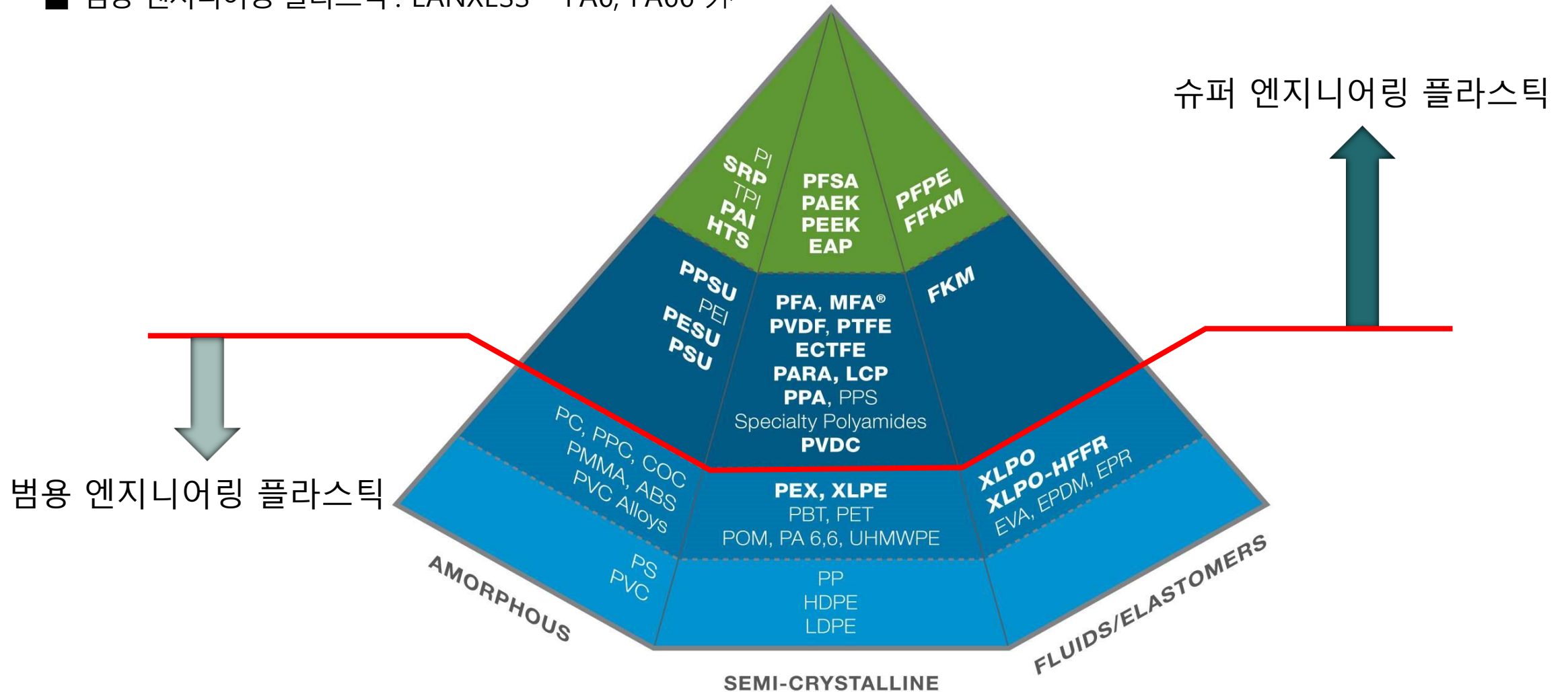


■ 금형 및 사출조건 개선지원



■ Plastic화 설계지원

- 슈퍼 엔지니어링 플라스틱 : SOLVAY – PPA, PPS, PEEK, PAI, FKM 外
- 범용 엔지니어링 플라스틱 : LANXESS – PA6, PA66 外



### Spire® Ultra Polymers

AvaSpire® PAEK  
KetaSpire® PEEK  
PrimoSpire® SRP  
EpiSpire® HTS  
Torlon® PAI

### Solviva® Biomaterials

Zeniva® PEEK  
Proniva® SRP  
Veriva® PPSU  
Eviva® PSU

### Sulfone Polymers

Radel® PPSU  
Acudel® mod. PPSU  
Veradel® PESU  
Udel® PSU

### Semi-Aromatic Polyamides

Amodel® PPA  
Ixef® PARA

### Fluorinated Fluids

Fomblin® PFPE  
Galden® PFPE  
Solvera® PFPE  
Fluorolink® PFPE

### Fluoroelastomers/ Perfluoroelastomers

Tecnoflon® FKM  
Tecnoflon® FFKM

### Partially-Fluorinated Polymers

Halar® ECTFE  
Solef® PVDF

### Fluoropolymer Coatings

Halar® ECTFE  
Hyflon® PFA/MFA®  
Hylar® 5000 PVDF  
Hylar® PVDF

### Fully-Fluorinated Polymers

Algoflon® PTFE  
Polymist® PTFE  
Hyflon® PFA/MFA®  
Hyflon® AD

### Polymer Processing Aids

Tecnoflon® NM FKM  
Solef® 11010 PVDF

### Liquid Crystal Polymers

Xydar® LCP

### High-Barrier Polymers

Diofan® PVDC  
Ixxon® PVDC

### Cross-Linkable Compounds

Polidiamme® XLPO  
Cogegum® XLPO-HFFR  
Polidan® PEX/XLPE

### Specialties

Aquivion® PFSA  
Solvane™ EAP  
Solef® 80 000 e-PVDF  
Torlon® AI PAI for  
Coatings  
Virantage® Tougheners

■ SELCION® LCP series : 경박단소 부품에 적합한 고내열성, 우수한 성형성, 치수 정확성

| Grade | KD130NI<br>(BI)              | KD230NI<br>(BI) | KD235NI<br>(BI)         | KD240NI<br>(BI)    | KC184BLM   | KC184BW                                   | KB40BM                   | KD325BI<br>KD238V |
|-------|------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------|---|--------------------------|-------------------|
| 용도    | General Purpose<br>Connector | FPC, BTB        | FPC, BTB<br>Card socket | HDMI,<br>connector | CPU socket | Card socket<br>Memory socket<br>IO socket | Bobbin<br>Optical pickup | Camera<br>VCM     |



FPC, BTB



FPC, FFC



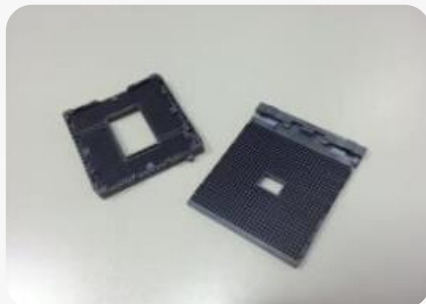
HDMI



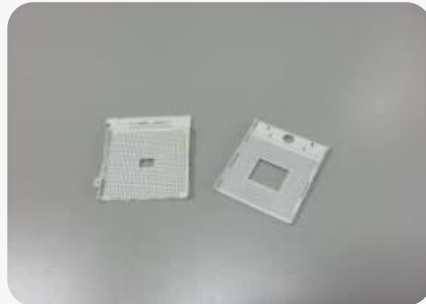
Camera VCM



Speaker frame



CPU socket



CPU socket cover



CF, PCMCIA



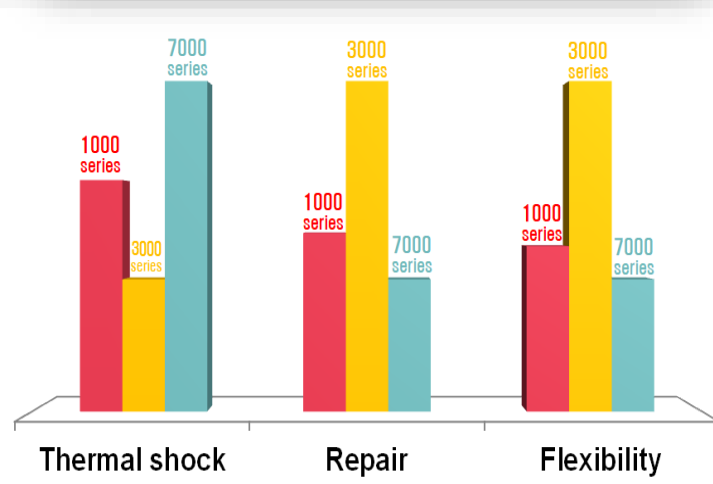
SATA socket



DDR memory

| 레진명        | 첨가제        | 그레이드              | 경쟁제품                 |
|------------|------------|-------------------|----------------------|
| <b>KB</b>  | >GF 40<    | <b>KB40BM</b>     | E4008MRB             |
| <b>KD</b>  | >GF+MD 35< | <b>KD235N(B)M</b> | S社 E6807LHF          |
|            | >GF+MD 40< | <b>KD240N(B)F</b> | S社 E6808UHF          |
|            | >GF+MD 50< | <b>KD250N(B)M</b> | S社 E6810LHF          |
|            | >GF+MD<    | <b>KD325BI</b>    | P社 E525T             |
|            | >GF+MD<    | <b>KD238V</b>     | C社 SEA 10/20/30      |
| <b>KDI</b> | >GF 30<    | <b>KD130N(B)I</b> | P社 / C社 E130i        |
|            | >GF+MD 32< | <b>KD230N(B)I</b> | P社 / C社 E473i        |
|            | >GF+MD 35< | <b>KD240N(B)I</b> | P社 / C社 E463i        |
|            | >GF+MD 45< | <b>KD245N(B)I</b> | P社 / C社 E481i        |
|            | >MD 25<    | <b>KD325BI</b>    | P社 E525T / C社 SEA10N |
| <b>KH</b>  | >GF 32<    | <b>KH230</b>      | P社 / C社 S475         |





Underfill is thermoset epoxy adhesives between semiconductor package(CSP, BGA,WLP) and PCB. Due to reduce a physical and chemical impact. It is located between the package and FR-4 board . And they distributes the stress caused by the difference of thermal expansion coefficient between chip and substrate, thereby improving reliability of parts.

언더필은 열 경화성 에폭시 수지 접착제로 외부의 화학적/물리적 충격으로부터 반도체 패키지 (CSP, BGA,WLP 와 PCB) 를 보호하는 역할을 합니다. 또한 패키지와 FR-4 기판 사이에 위치하여, 칩과 기판 사이의 열팽창 계수 차이로 발생하는 응력을 고르게 분산시켜 부품의 신뢰성을 향상시킵니다.

### ○ Applications

: Automobile module, Fingerprint module, Wearable devices

#### 1000 series

- Fast cure, Excellent adhesion 속 경화, 우수한 접착강도
- Good toughness, Good water absorption 내 충격성, 내 흡습율

#### 3000 series

- Fast cure, Long pot life 속 경화, 긴 가사시간
- Excellent drop impact, Excellent re-workability 우수한 낙하충격, Re-Work 우수

#### 7000 series

- Fast cure, Low viscosity, High Tg 속 경화, 저 점도, 높은 유리전이 온도
- Excellent thermal shock reliability 우수한 열 충격 신뢰성

### Thermal Curing Adhesives

\* It can be developed to suit the user's needs.  
User 요구사항에 맞춤 개발 가능

| Model     | Appearance   | Viscosity<br>[cps] | Tg [°C]<br>by DSC | CTE (ppm/°C)    |                 | Cure condition | Pot Life<br>[day] |
|-----------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
|           |              |                    |                   | $\alpha 1^{1)}$ | $\alpha 2^{2)}$ |                |                   |
| WE-1007N  | Light Yellow | 2,500              | 90                | 60              | 220             | 135°C@20min    | 7                 |
| WE-1007NB | Black        | 2,500              | 90                | 60              | 220             | 135°C@20min    | 7                 |
| WE-3008S1 | Light Yellow | 2,800              | 7                 | 46              | 225             | 135°C@10min    | 20                |
| WE-3008B1 | Black        | 2,800              | 7                 | 46              | 225             | 135°C@10min    | 20                |
| WE-3008SN | Black        | 2,500              | 8                 | 45              | 235             | 135°C@10min    | 20                |
| WE-3009S  | Black        | 2,100              | 16                | 45              | 255             | 135°C@10min    | 20                |
| WE-7101   | Black        | 150                | 100               | 58              | 196             | 135°C@20min    | 3                 |
| WE-7104   | Black        | 400                | 100               | 57              | 195             | 135°C@20min    | 3                 |
| WE-7109   | Black        | 900                | 100               | 57              | 194             | 135°C@20min    | 3                 |
| WE-7115   | Black        | 1,500              | 100               | 58              | 191             | 135°C@20min    | 3                 |
| WE-7703   | Black        | 300                | 70                | 49              | 225             | 135°C@20min    | 3                 |

1)  $\alpha 1$ : Below Tg 2)  $\alpha 2$ : Above Tg



It is an adhesive with fast curing at low temperature which can be applied to various adhered materials such as plastic materials, glass, and metals. We have many know-how about adhesives that can be applied to camera module, fingerprint module, speaker module, glob top encapsulants, LED BLU, etc.

저온에서 속경화가 가능한 접착제로서 플라스틱재질·유리·금속 등의 다양한 재질에 적용 가능합니다.

또한 점도·적소성·유리전이온도, 경도 등을 적용 재질에 따라 안정적으로 조절이 가능합니다.

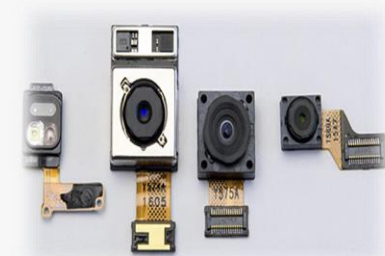
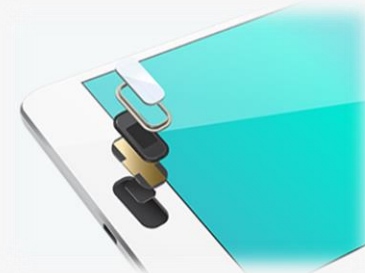
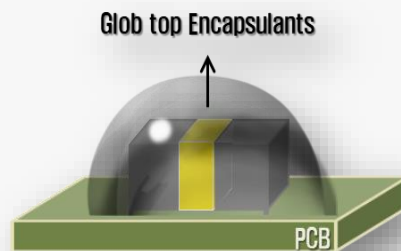
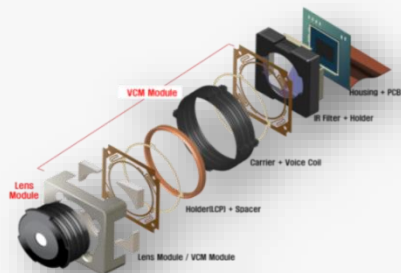
대표적으로 카메라 모듈·지문인식 모듈·스피커 모듈·Glob top·LED BLU등에 적용 가능한 제품과 각각의 요구하는 특성에 대하여 많은 노하우를 보유하고 있습니다.

### ○ Product Feature

- Resin-Bleed issues solution. 석출물 현상 해결가능
- Low CTE. 낮은 열팽창계수
- Excellent thermal shock reliability. 우수한 열 충격 신뢰성

### ○ Applications

: Automobile module, Fingerprint module, Wearable devices



### Thermal Curing Adhesives

\* It can be developed to suit the user's needs.  
User 요구사항에 맞춤 개발 가능

| Model        | Appearance    | Viscosity [cps] | Ti  | Tg [°C] by DSC | CTE (ppm/°C)    |                 | Cure condition | Pot Life (day) | Applications   |
|--------------|---------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--|
|              |               |                 |     |                | $\alpha 1^{1)}$ | $\alpha 2^{2)}$ |                |                |  |
| WE-4802      | Black         | 4,500           | 2.0 | 42             | 38              | 148             | 80°C@30min     | 3              | Camera Module<br>- Bracket (Flange)<br>- Lens<br>- Die<br>- Housing<br>- VCM |
| WE-4132L(C2) | Black         | 6,700           | 2.0 | 18             | 38              | 134             | 80°C@30min     | 3              |  |
| WE-4332      | Black         | 7,800           | 3.8 | 9              | 55              | 169             | 80°C@30min     | 3              |  |
| WE-4334      | Black         | 8,200           | 3.0 | 35             | 55              | 160             | 80°C@30min     | 3              |  |
| WE-4335      | Black         | 14,000          | 3.0 | 35             | 56              | 158             | 80°C@30min     | 3              |  |
| WE-D524      | Red           | 22,000          | 5.0 | 42             | 45              | 150             | 80°C@30min     | 3              |  |
| WE-4340      | Black         | 23,000          | 3.0 | 44             | 44              | 153             | 80°C@30min     | 3              |  |
| WE-4341      | Black         | 26,000          | 6.0 | 36             | 45              | 161             | 80°C@30min     | 3              | LED BLU  |
| WE-4539YN    | White         |                 |     |                |                 |                 | 80°C@20min     | 3              |  |
| WE-4430B     | Black         | 20,000          | 4.5 | 40             | 45              | 185             | 80°C@20min     | 3              | Glob-Top encapsulants  |
| WE-2120W     | Milky White   | 10,000          | 3.0 | 23             | 46              | 220             | 135°C@10min    | 10             |  |
| WE-2120GC    | Midnight Blue | 12,500          | 3.0 | 34             | 49              | 212             | 135°C@10min    | 10             | Finger Print Scan  |
| WE-3009A     | Light Yellow  | 2,200           | 1.0 | 15             | 58              | 210             | 135°C@20min    | 7              |  |
| WE-3240YN    | Clear         | 9,500           | 1.0 |                |                 |                 | 80°C@30min     | 3              |  |

1)  $\alpha 1$ : Below Tg 2)  $\alpha 2$ : Above Tg



UV curing enables fast curing within a short time, and the process is simple, so it can maximize customers' productivity.

In addition, viscosity, rigidity, glass transition temperature, hardness, flexibility and toughness can be adjusted stably depending on the applied material.

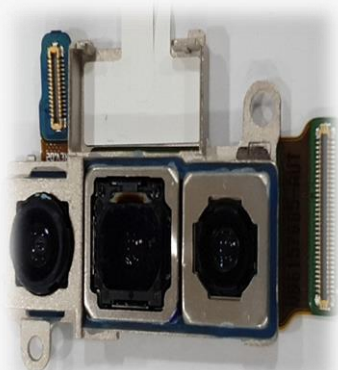
UV경화를 통해 단시간내에 빠른 경화가 가능하며, 공정이 단순하여 고객의 생산성을 극대화 할 수 있습니다. 또한 점도, 칙소성, 유리전이온도, 경도, Flexibility, Toughness를 적용 재질에 따라 안정적으로 조절이 가능합니다.

### ○ Product Feature

- Excellent Adhesion. 우수한 접착력
- High elongation. 높은 연신율

### ○ Applications

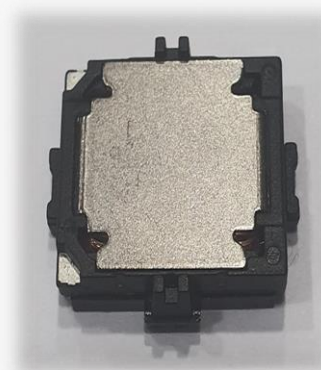
: Camera module, Flange (Bracket), IR Filter, Speaker module, Nail Art



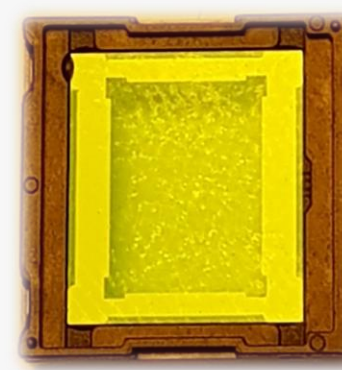
Flange (Bracket) Bonding



Lens Bonding



Speaker Module



IR Filter



Nail Art – Cubic

### ○ UV Curing Adhesives

\* It can be developed to suit the user's needs.  
User 요구사항에 맞춤 개발 가능

| Model       | Appearance            | Viscosity [cps] | Ti  | Hardness <sup>3)</sup> | Cure condition [mJ / cm <sup>2</sup> ] | Applications                        |
|-------------|-----------------------|-----------------|-----|------------------------|--|-------------------------------------|
| WU-5704S    | Translucence          | 4,500           | 3.5 | 60(D)                  | ≤2,000                                 | C/M Flange (Bracket)<br><br>Bonding |
| WU-5704SB   | Blue                  | 4,500           | 3.5 | 60(D)                  | ≤6,000                                 |                                     |
| WU-8737H    | Translucence          | 8,500           | 3.5 | 60(D)                  | ≤5,000                                 |                                     |
| WU-8602     | Translucence          | 7,000           | 3.0 | 65(D)                  | ≤6,000                                 |                                     |
| WU-8735L-PL | Translucence          | 6,000           | 4.5 | 65(D)                  | ≤6,000                                 |                                     |
| WU-8735R-01 | Translucence          | 8,500           | 3.0 | 75(D)                  | ≤6,000                                 |                                     |
| WU-8800     | Translucence          | 7,300           | 4.0 | 70(D)                  | ≤6,000                                 |                                     |
| WU-8800VR   | Red                   | 7,000           | 3.2 | 60(D)                  | ≤6,000                                 |                                     |
| WU-9007     | Translucence          | 12,000          | 1.4 | 25(D)                  | ≤4,000                                 | C/M IR Filter                       |
| WU-9008     | Translucence          | 8,500           | 3.0 | 75(D)                  | ≤4,000                                 |                                     |
| WU-5100     | Yellowish Fluorescent | 5,300           | 2.5 | 35(D)                  | ≤3,000                                 | Speaker Module                      |
| WU-5705GB   | Blue                  | 4,500           | 3.5 | 65(D)                  | ≤2,000                                 |                                     |
| WU-1101     | Clear                 | 4,700           | 3.0 | 55(D)                  | ≤500                                   | Nail Art - Cubic                    |

1) α1: Below Tg 2) α2: Above Tg

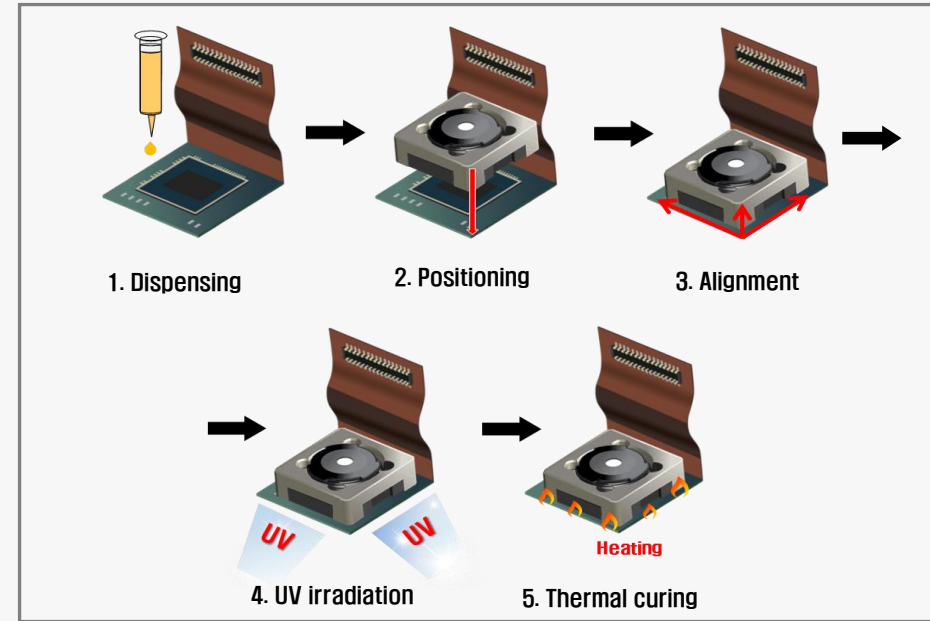
It is mainly used for the purpose of preventing of the lens distortion.

In case of thermal curing, when the camera lens is moved in the production line , a defocus phenomenon occurred due to vibration.

This phenomenon is causes defects.

To solve this problem, the primary UV-cured bonding process(instant temporary bonding) aligned the lens position. After the primary curing process, the lens is completely cured by the secondary heat-cured bonding process.

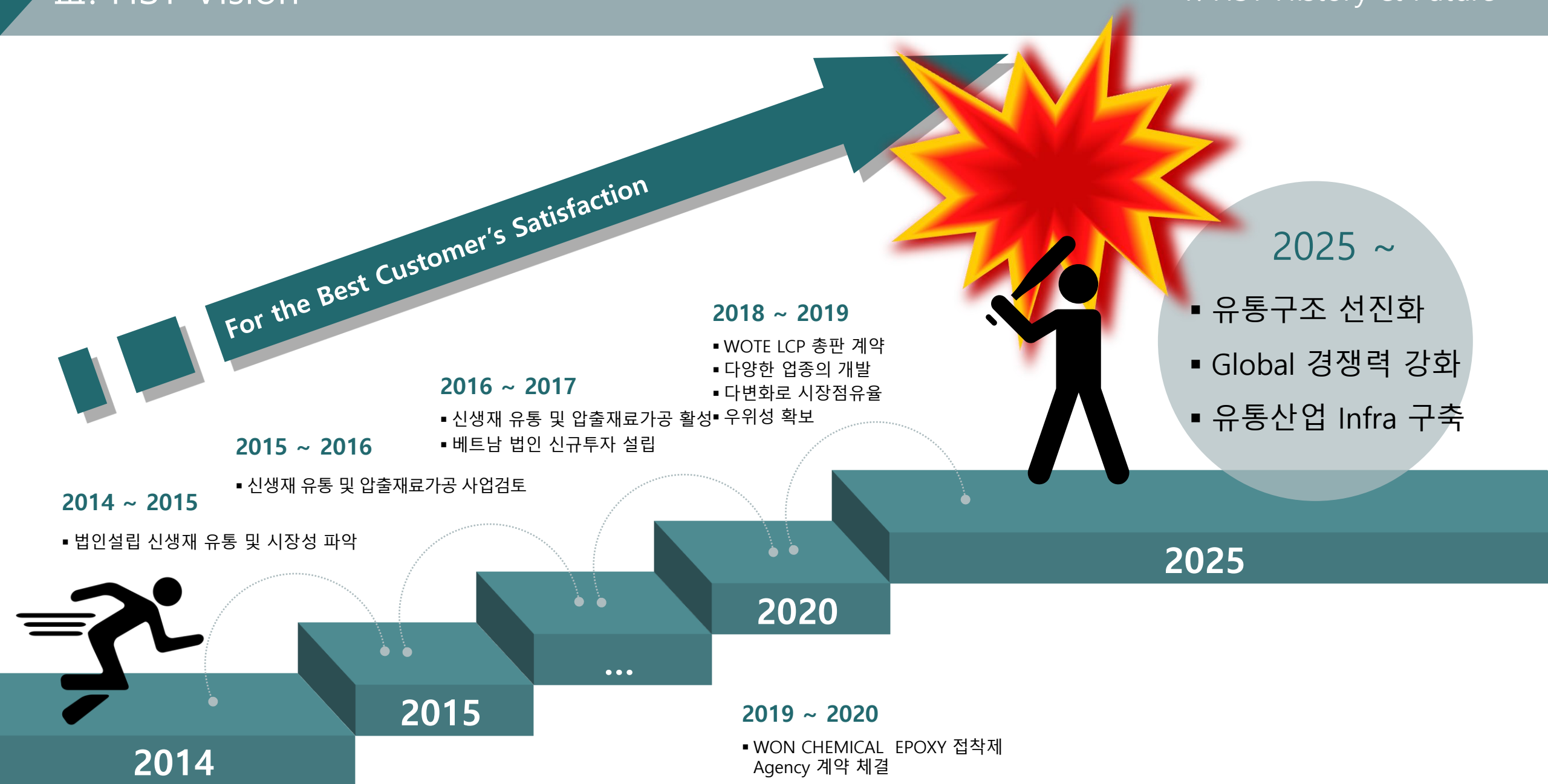
Dual cure adhesives는 주로 렌즈의 초점 뒤틀림 방지 목적으로 사용된다. 열 경화의 경우 생산 라인 이동 시, 진동에 의한 초점이 어긋나는 현상이 발생하여 불량률을 야기 시킨다. 이를 해결하고자 1차 UV경화(순간 가 접착)으로 렌즈의 위치를 정렬시켜 준 뒤, 2차 열 경화로 완전 경화 시켜 준다.



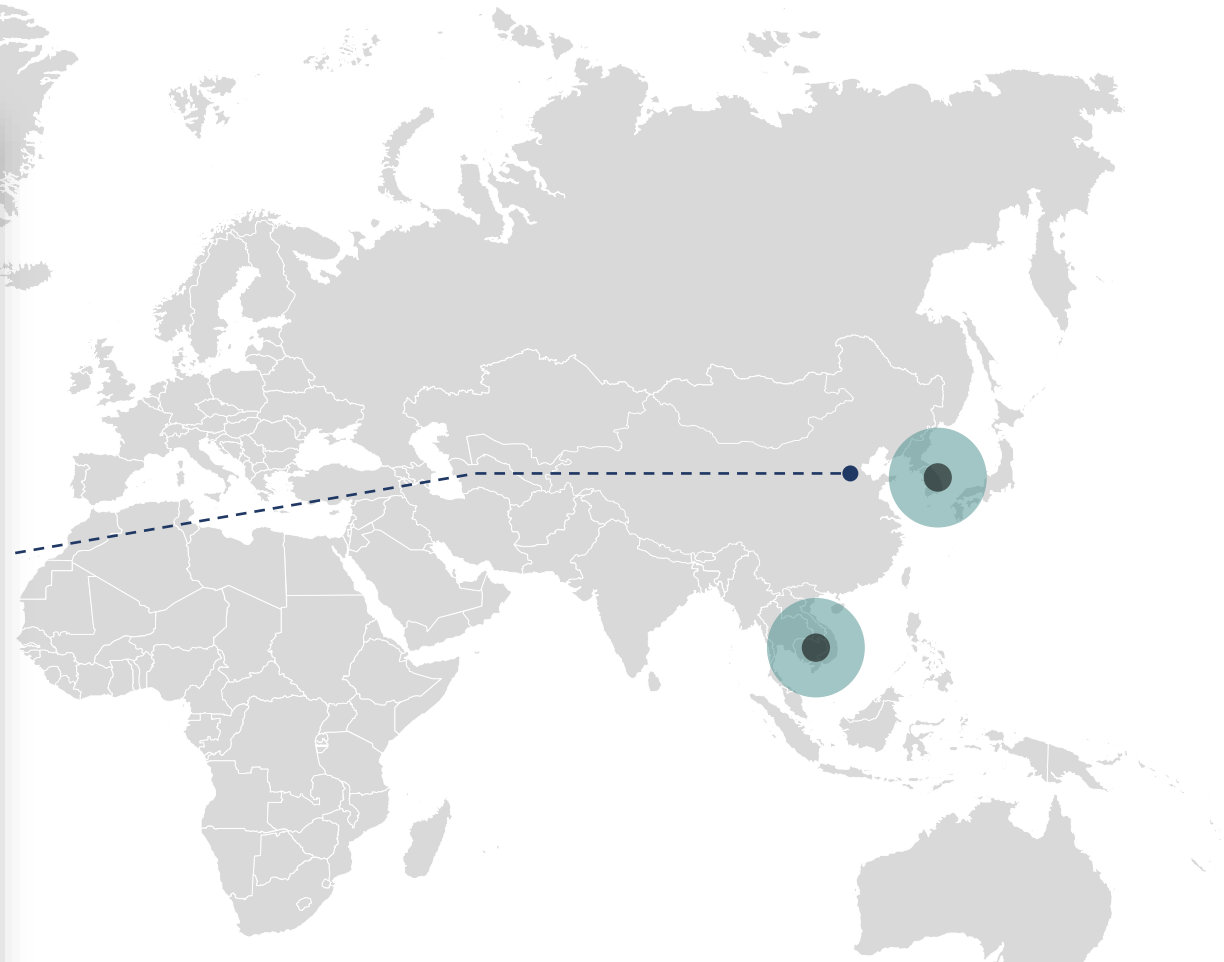
### ○ UV Curing Adhesives

\* It can be developed to suit the user's needs.  
User 요구사항에 맞춤 개발 가능

| Model         | Appearance   | Viscosity (cps) | Ti  | Tg [°C]<br>by DSC | Cure condition     | Applications     |
|---------------|--------------|-----------------|-----|-------------------|--------------------|------------------|
| WD-6023       | Milky Haze   | 28,000          | 4.5 | 110               | ≥2000mJ+80°C@60min | Normal           |
| WD-6412N2(C2) | Dark Gray    | 45,000          | 6.0 | 27                | ≥1000mJ+80°C@30min | Active Alignment |
| WD-6411H      | Dark Gray    | 8,500           | 3.0 | 18                | ≥1000mJ+80°C@30min | Normal           |
| WD-6411LV     | Dark Gray    | 4,500           | 1.5 | 18                | ≥1000mJ+80°C@30min | Lens Bonding     |
| WD-6412P3     | Light Yellow | 23,000          | 2.5 | 25                | ≥1000mJ+80°C@30min | Car Black Box    |



#### ■ 회사 약도(본사)



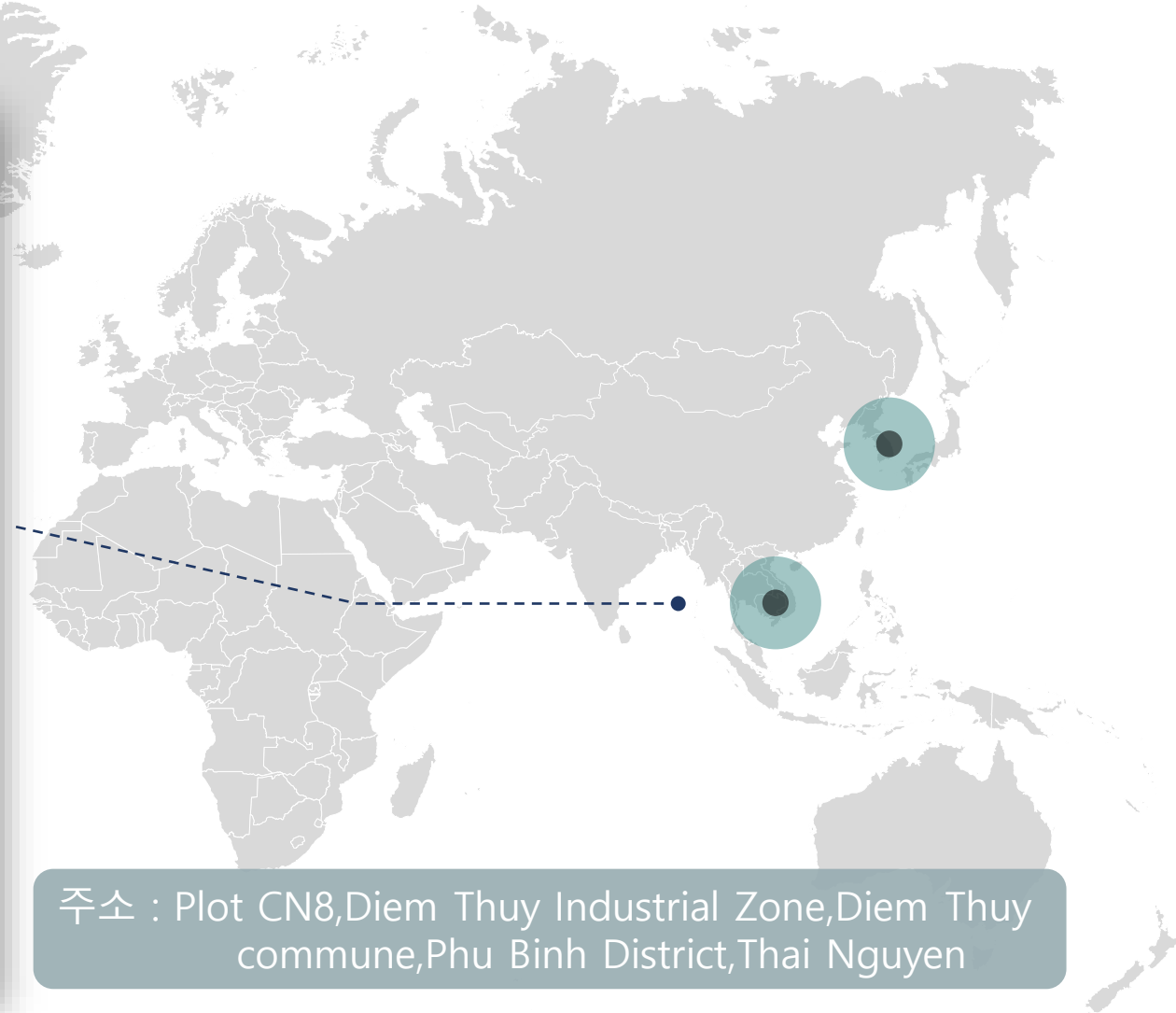
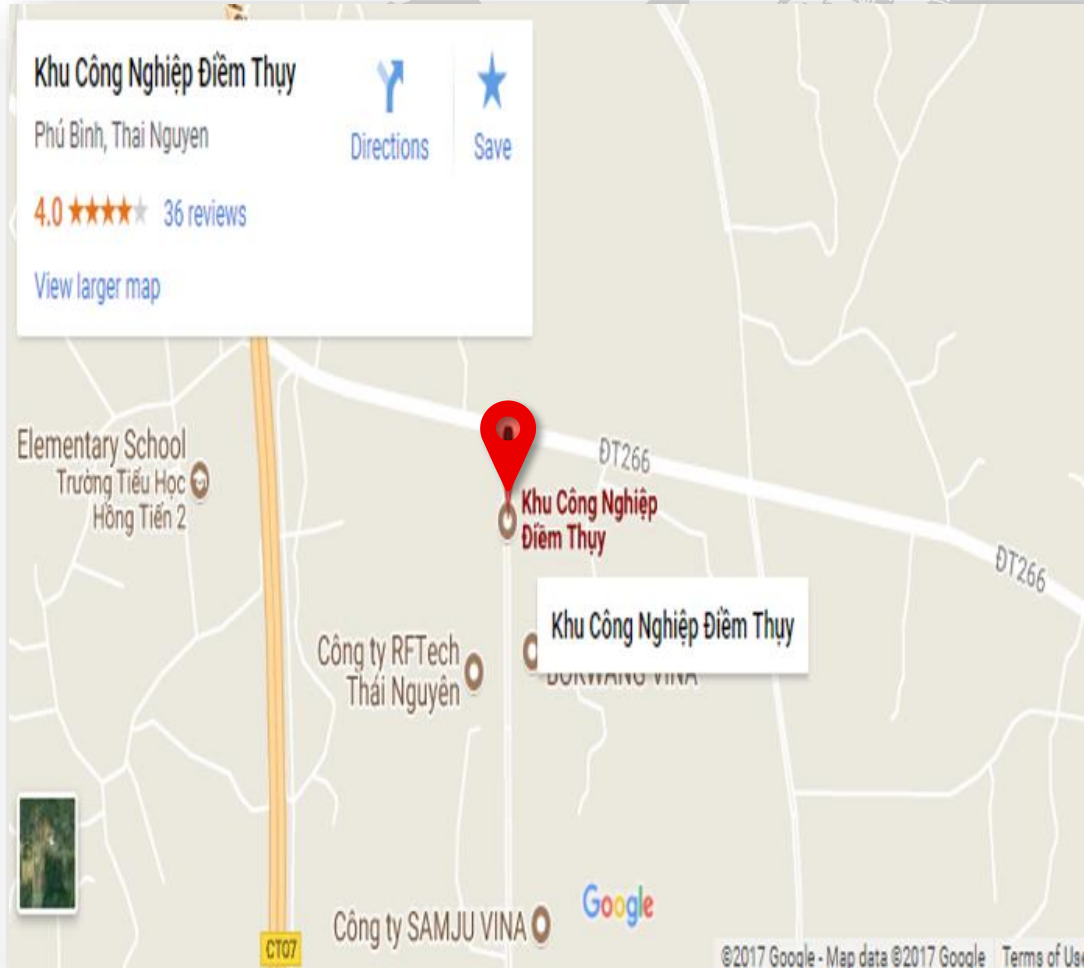
주소 : 인천시 남동구 호구포로 183 후이즈스마트타워 206호

### ■ 회사 약도(공장)



주소 : 인천광역시 남동구 고잔로 54 (고잔동 382-14)

#### ■ 회사 약도(베트남)



주소 : Plot CN8, Diem Thuy Industrial Zone, Diem Thuy commune, Phu Binh District, Thai Nguyen

An aerial photograph of the New York City skyline, featuring the Empire State Building prominently in the center. The image is framed by large, overlapping geometric shapes in shades of grey, blue, and teal. The text '감사합니다.' is written in a large, teal, sans-serif font on the right side of the image.

감사합니다.